

证券代码：000021

证券简称：深科技

深圳长城开发科技股份有限公司
2025 年 11 月 26 日投资者关系活动记录表

编号：2025-009

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称 及人员姓名	东方证券 万家基金
时间	2025 年 11 月 26 日
地点	公司本部会议室
上市公司 接待人员姓名	董事，副总裁周庚申 董事会秘书钟彦 证券事务代表刘玉婷
投资者关系 活动主要内容介绍	本次会议主要介绍了公司概况、发展历程、全球布局、核心竞争优势以及产品与业务，并就调研投资者关心的公司所处行业动态、三大主营业务情况、未来发展方向等有关问题进行了解答。 一、公司基本情况介绍 公司是全球领先的专业电子制造企业，连续多年在 MMI（Manufacturing Market Insider）全球电子制造服务行业（Electronic Manufacturing Service, EMS）排名前列。公司专注于为客户提供技术研发、工艺设计、生产制造、供应链管理、物流、销售等一站式电子产品制造服务。以先进制造为基础，以市场和技术为导向，公司坚持高质量发展，构建了以存储半导体、高端制造、计量智能终端为三大主营业务的发展战略。 二、交流环节 1、请问公司所处的目前半导体行业的情况如何？ 答：据美国半导体行业协会（SIA）报告，2025年6月全球半导体行业

	销售额达599亿美元，同比增长19.6%，其中中国市场同比增长13.1%。聚焦于封装测试行业，TrendForce集邦咨询数据显示，2024年全球前十大封测厂合计营收为415.6亿美元，年增长3%。在先进封装这一关键增长领域，咨询公司YoleGroup研究预测，2025年全球先进封装市场总营收预计将达到569亿美元，同比增长9.6%。 2、公司存储芯片封装是否存在技术壁垒？ 答：公司存储芯片封装在行业中存在较高的技术壁垒。作为国内高端存储芯片封测的龙头企业，公司拥有行业经验丰富的研发和工程团队，具备精湛的多层堆叠封装工艺能力和测试软件开发能力。 3、公司在高端制造板块的未来规划是什么？ 答：公司将高壁垒、高附加值业务作为发展重点，持续深化数字化转型，以智能制造、数字化运营及智慧供应链为核心驱动力，充分发挥全球化产业布局优势，促进高端电子制造国内国际双循环。不断增强高端制造体系化和柔性化能力，通过持续推进数字化赋能与AI的应用，打造智能化、绿色化、协同化的高端电子制造业务，向更具供应链解决方案的制造服务商转型，从中国制造向中国创造转变。面向精益管理、黑灯工厂、智能制造，培育创造新质生产力，从中国速度向中国质量转变。 接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 11 月 26 日